

塑封知识竞赛考试题库

共 26 页 90 道题

塑封工序清润模作业后需使用假片（Dummy）试模_____次，在检验假片（Dummy）外观无异常的情况下，开始加工正式产品。[单选题] *

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.4

塑封设备状态标识牌状态有正常生产、停机待料、维护保养、_____。[单选题]

*

A.维修调试(正确答案)

B.维护调试

C.停止生产

D.停机维修

塑封工序在接触产品时要求所有人员必须戴_____。[单选题] *

A.棉线手套(正确答案)

B.乳胶手套

C.指套

D.裸手

产品上机前流程卡上必须产生一个正确的_____，而且工作桌上只允许放置一个弹夹。 [单选题] *

- A.盒号
- B.弹夹号(正确答案)
- C.加工数
- D.合格数

弹夹号操作员确认无误后一次性填写，如需修改必须在_____确认签名后修改。 [单选题] *

- A.倒班技术员
- B.领班(正确答案)
- C.主管
- D.工程师

塑封模盒的排气槽堵塞，所包封的产品会出现_____。 [单选题] *

- A.塑封体未填充(正确答案)
- B.错位
- C.压边
- D.粘模

塑封使用_____传递未塑封产品 [单选题] *

A.笼车

B.AGV

C.平板传递车

D.减震传递车(正确答案)

首件检验由操作员完成后，交付_____确认，合格后方可生产。 [单选题] *

A.其他作业员

B.倒班技术员(正确答案)

C.领班

D.工艺员

以下那些缺陷不可能是塑封产生的_____。 [单选题] *

A.塑封体未填充

B.共面性不良(正确答案)

C.错位

D.封反

以下哪些缺陷只有塑封有可能造成的_____。 [单选题] *

A.分层

B.塌丝

C.断丝

D.塑封体未填充(正确答案)

错位/偏心量测的仪器是_____。 [单选题] *

A.X-RAY

B.SCAN

C.投影仪(正确答案)

D.显微镜

MGP模塑封作业员从_____中拿取产品，放置在排片机或工作台上。 [单选题] *

A.氮气柜

B.压焊窗口

C.传递车

D.机台旁的暂存柜(正确答案)

在连续成模过程中发生脱模不畅、堵塞排气槽、粘流道等异常现象时，把模具清理干净之后需润模一般润模次数为_____。 [单选题] *

A.2次(正确答案)

B.3次

C.1次

D.4次

模具维修，调试时，禁止旁人开机，以免造成_____损伤。 [单选题] *

A.设备/模具

B.设备/人身

C.人身/模具(正确答案)

D.设备/产品

供H客户产品载体分层面积不能大于载体总面积的_____。 [单选题] *

A.10%(正确答案)

B.15%

C.20%

D.25%

供样H客户产品塑封后的需在_____h内开始后固化; [单选题] *

A.2

B.4(正确答案)

C.6

D.8

ASM 3G塑封自动系统无下面哪项安全保护装置_____。 [单选题] *

A.光幕保护

B.紧急停止按钮

C.双手挚按钮(正确答案)

D.安全门

塑封作业员在作业过程中不小心将待封产品打翻后应如何处理_____ [单选题] *

A.保护现场，报告领班;(正确答案)

B.保护现场，报告师傅;

C.将产品捡起，报告领班;

D.将产品捡起继续加工

DIP008封装形式产品，胶体非芯片区域背面气孔的检验标准为_____ [单选题] *

A.直径>0.508mm或深>0.3mm;

B.直径>0.508mm或深>0.4mm;(正确答案)

C.直径>0.254mm或深>0.4mm;

D.直径>0.508mm或深>0.5mm;

塑封模具温度的测量监控频次是:_____ [单选题] *

A.1次/1天/设备

B.1次/6天/设备(正确答案)

C.1次/7天/设备

D.1次/1月/设备

塑封料使用必须遵循_____原则 [单选题] *

A.先进先出;(正确答案)

B.先进后出;

C.先进不出;

D.后进不出

每次作业前必须用防静电刷和气枪清理模具，清理顺序:_____ [单选题] *

A.先注塑头后模具（先上模后下模）、先刷后吹;(正确答案)

B.下模、上模、注塑头（待注塑头自动升起时清理）;

C.上模、注塑头（待注塑头自动升起时清理）、下模;

D.注塑头（待注塑头自动升起时清理）、下模、上模.

操作员若发现弹夹号错误，必须向_____反映。 [单选题] *

A.操作员;

B.倒班技术员;

C.领班;(正确答案)

D.工程师

《生产过程异常反馈处置作业指导书》定义，异常发生后，_____小时内开出NCL、CAR单。 [单选题] *

A.1小时(正确答案)

B.2小时

C.3小时

D.4小时

防静电鞋的主要作用是_____ [单选题] *

- A.人体接地的媒介;(正确答案)
- B.屏蔽人员脚部的静电
- C.防止人体产生的灰尘扩散
- D.作业员穿着舒适

对8D步骤的主要目标说法正确的是:_____ [单选题] *

- A.保护客户、清除问题根因、防止复发(正确答案)
- B.减少误差、降低成本和解决问题
- C.客户要求解决质量问题
- D.按客户要求系统性解决问题

塑封工序目前测量模具温度使用的工具是_____ [单选题] *

- A.温度计
- B.湿度计
- C.热敏金属点温计(正确答案)
- D.红外线点温计

在设备运行过程中不幸发生安全事故时,应先按下_____键 [单选题] *

- A.停止键
- B.复位键

C.电源按钮

D.紧急停止键(正确答案)

停机后立即将塑封料袋扎紧，是防止塑封料_____ [单选题] *

A.吸潮(正确答案)

B.散落

C.减少

D.混料

塑封料回温后使用时间超过72h的，应_____ [单选题] *

A.二次回温后使用

B.报废处理(正确答案)

C.继续使用

D.反馈供应商处理

塑封后产品芯片及内引脚压焊区分层检验标准为_____ [单选题] *

A.塑封体面积的10%

B.塑封体面积的15%

C.塑封体面积的20%

D.芯片表面及引脚打线区不允许有分层(正确答案)

塑封料第一次回温后的使用时限为_____ [单选题] *

- A.48小时
- B.36小时
- C.60小时
- D.72小时(正确答案)

转到塑封工序的产品在氮气柜中_____天内未能塑封，塑封加工前需要进行烘烤去湿。 [单选题] *

- A.5天
- B.7天(正确答案)
- C.10天
- D.3天

塑封后SOT系列非特殊布线产品冲弯率为_____ [单选题] *

- A.5%
- B.10%
- C.15%(正确答案)
- D.25%

塑封后产品非芯片及内引脚压焊区，载体打线区分层检验标准为_____ [单选题] *

- A.塑封体面积的10%(正确答案)
- B.塑封体面积的15%
- C.塑封体面积的20%

D.不允许有分层

我司塑封料回温时间为_____ [单选题] *

A.48小时

B.16小时

C.60小时

D.24小时(正确答案)

转到塑封工序的产品在氮气柜中保存，由_____配送至设备旁的暂存柜内。

[单选题] *

A.作业员

B.配料员(正确答案)

C.领班

D.困料员

当引线框架上机后有定位不良现象时技术员应用_____辅助定位。 [单选题] *

A.铝片

B.橡胶片

C.铜片(正确答案)

D.镊子

塑封后产品芯片区域空洞的标准为_____ [单选题] *

- A.空洞尺寸>0.3mm为REJ;
- B.空洞尺寸>0.254mm为REJ;
- C.空洞尺寸>0.127mm为REJ;
- D.不允许有空洞;(正确答案)

塑封前等离子清洗水滴角标准为_____ [单选题] *

- A.≤40°
- B.≤35°(正确答案)
- C.<40°
- D.<35°

塑封料包装应良好，标注应清晰，并且标注内容必须包含_____。 *

- A.塑封料型号(正确答案)
- B.塑封料批号(正确答案)
- C.塑封料规格(正确答案)
- D.塑封料有效期限(正确答案)

塑封产品定位孔变形对后工序造成的影响可能有_____。 *

- A.塌丝
- B.断丝
- C.胶体打烂(正确答案)
- D.印字偏移(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797006126065006056>